PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-330864

(43) Date of publication of application: 30.11.2001

(51)Int.CI.

G02F 1/155

B60R 1/04 1/15

(22)Date of filing:

G02F

(21)Application number: 2000-150289

(71)Applicant: MURAKAMI CORP

(72)Inventor: TERADA YOSHIYUKI

MOCHIZUKA TAKUO

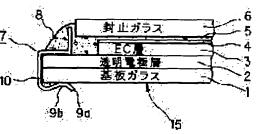
(54) ELECTRODE STRUCTURE OF EC MIRROR

22.05.2000

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a clip which improves the workability of mounting the clip to a substrate, prevents the flawing of a take-out electrode part, makes the clip itself hardly deformable in fitting of the clip to the substrate, has the high fitting power to the substrate and has a structure not entailing the contact defect with the take-out electrode part and the clip during the expansion of a sealing resin.

SOLUTION: One of both side pieces facing each other 10 of the U-shaped clip, which exists on a conductive film side, is formed to a plane shape and the other which exists on the glass substrate side is formed to a curvilinear shape, of which the end opens round toward the outer side. The central segments of these side pieces are formed to such a projecting shape at which the openings are narrowed.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-330864

(P2001-330864A) (43)公開日 平成13年11月30日(2001.11.30)

(51) Int. C1.	7	識別記号	FΙ			テーマコート・	(参考)
G02F	1/155		G02F	1/155		2K001	
B60R	1/04		B60R	1/04	I	١	
G02F	1/15	501	G02F	1/15	501		

審査請求 有 請求項の数2 〇1. (全4頁)

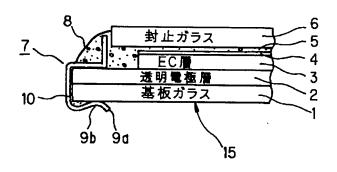
		毎旦明示 有 明示項の数2 OL (至4貝)				
(21)出願番号	特願2000-150289(P2000-150289)	(71)出願人 000148689				
		株式会社村上開明堂				
(22)出願日	平成12年5月22日(2000.5.22)	静岡県静岡市宮本町12番25号				
		(72)発明者 寺田 佳之				
		静岡県藤枝市高岡1-4-33-106				
		(72)発明者 持塚 多久男				
	,	静岡県榛原郡金谷町志戸呂143				
		(74)代理人 100072224				
		弁理士 朝倉 正幸				
		Fターム(参考) 2K001 AA10 BA16 BB04 CA08 CA19				
		CA20 CA35				

(54) 【発明の名称】 ECミラーの電極構造

(57)【要約】

し、また取り出し電極部の傷付きを防ぎ、さらクリップの基板への嵌め込み時にクリップ自体を変形させにくくし、そして基板への嵌合力が高く、封止樹脂の膨張時に取り出し電極部とクリップとの接触不良を招くことのない構造をもつたクリップを提供することを課題とする。 【解決手段】 コ字形クリップの対向する両側片のうち、導電膜側に位置した一方は平面形状に形成し、ガラス基板側に位置した他方は、端部が外側が向かって丸く開いた湾曲形状をなしかつ該側片の中央部分は開口が狭まるような凸形状に形成したことを特徴とする。

クリップの基板への取付け作業性を良好に



【特許請求の範囲】

【請求項1】 曲率を有するガラス基板上(1)に、第 1の電極としての透明導電膜(2)、透明導電膜上に成 膜したEC膜(3)、及びEC膜上に成膜した第2の電 極兼反射膜(4)を順次成膜し、その上に封止樹脂層

(5) 及び保護層(6)を設け、かつ前記第1の電極及 び第2の電極の取り出し電極にそれぞれ断面がほぼコ字 形でかつバネ性を有したクリップ(7)を取付けてなる エレクトロクロミックミラーの電極部の構造において、 ち、導電膜側に位置した一方(8)は平面形状に形成 し、ガラス基板側に位置した他方(9)は端部(9a) が外側に向かって丸く開いた湾曲形状をなし、かつ該側 片の中央部分は、コ字形開口が狭まるような凸形状 (9) b) に形成したことを特徴とするECミラーの電極構 造。

【請求項2】 クリップの両側片にはクリップの長手方 向と直交する方向に割り(11)を形成するとともに、 前記両側片の何れか一方に、外部配線接続用ターミナル (12)を形成してなる請求項1に記載のECミラーの 20 電極構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車用防眩ミラ ーとして好適なエレクトロクロミックミラー(以下EC ミラーという)の電極部に用いるクリップの改良に関す る。

[0002]

【従来の技術】自動車のバックミラーにおいて、電気的 制御に応じて光透過率が変化するエレクトロクロミック 30 素子(以下EC素子という)を利用した自動車用EC式 防眩ミラーは知られている。

【0003】 E C素子には液体タイプのものと固体タイ プのものとがあるが、視認性、安全性、耐久性等の面で 優れた固体タイプのEC素子が、自動車のミラーに好適 に使用されている。前記固体形EC素子を利用したEC 式防眩ミラーに関する技術については、例えば実公平5 -26576号公報、実公平6-31451号公報、特 開平8-3593号公報、特開昭63-23143号公 報に提案されている

【0004】固体形EC素子を用いたECミラーは、図 1、図2に概略示すように、ガラス等の基板1の背面に 第1の電極である透明電極層2、第1発色層、固体電解 質層、第2発色層からなるEC層3及び第2の電極兼反 射層4並びに封止樹脂層5及び保護ガラス層6を積層し て形成されている。第1の電極層2及び第2の電極層4 の詳細は、図示省略したが所定のパターンに形成され、 それぞれに取り出し電極部を設ける。取り出し電極部に は外部電圧を供給させるために、りん青銅などのバネ性 を有する金属クリップ7を取り付け、該クリップのター 50

ミナルに外部配線をハンダつけする方法が一般的であ る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来から用い られているクリップHの形状は、特開昭63-2314 3号公報等にも示されるように、入り口側が狭く、奥ま ったところが広くなった、断面がほぼ「ム」或いは「ハ ート」の形状をしている(図5)。このような形状をも つ従来クリップを基板に嵌め込んで取付ける際に入り口 前記コ字形クリップの対向する両側片(8)(9)のう 10 が狭いので、入り口をこじ開ける必要があり、取付け作 業性が落ちる。さらに基板に両側片を嵌め込む際に、E C素子の取り出し電極部を傷付けやすいという欠点もあ る。またクリップを基板に嵌め込むときに変形させやす いという欠点もあった。さらに取り付け時に、ほぼ対称 的に形成された両側片で基板の両面を平面的に挟みおさ えるだけの構造であったので基板への嵌合力が弱く、外 れ易いという問題もある。

> 【0006】またクリップの側片は、基板への嵌合力が 弱いことから、図5(A)、(B)に示したように封止 樹脂Rが前記側片の内側に隙間に浸入しやすく、これに 起因して浸入した封止樹脂Rが高温・高湿条件下におい て膨張したとき、クリップのターミナルを押し上げ(図 6参照)、取り出し電極部とクリップとの接触不良を招 くという虞があった。

> 【0007】本発明は上記事情に鑑みなされたものであ り、その目的とするところは、クリップの基板への取付 け作業性を良好にし、また取り出し電極部の傷付きを防 ぎ、さらクリップの基板への嵌め込み時にクリップ自体 を変形させにくくし、そしてまた、基板への嵌合力が高 く、封止樹脂の膨張時に取り出し電極部とクリップとの 接触不良を招くことのない構造をもつたクリップを提供 することを課題とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明にかかるECミラ 一の電極構造は、上記目的を達成するために、下記の構 成を採用した。

(1) 曲率を有するガラス基板上に、第1の電極として の透明導電膜、透明導電膜上に成膜したEC膜、及びE C膜上に成膜した第2の電極兼反射膜を順次成膜し、そ 40 の上に封止樹脂層及び保護層を設け、かつ前記第1の電 極及び第2の電極の取り出し電極にそれぞれ導電性材料 から形成された断面がほぼコ字形で、かつバネ性を有し たクリップを取付けてなるエレクトロクロミックミラー の電極部の構造において、前記コ字形クリップの対向す る両側片のうち、導電膜側に位置した一方は平面形状に 形成し、ガラス基板側に位置した他方は、端部が外側に 向かって丸く開いた湾曲形状をなしかつ該側片の中央部 分は開口が狭まるような凸形状に形成したことを特徴と する。

(2)請求項2に記載のECミラーの電極構造は、クリ

ップの両側片にはクリップの長手方向と直交する方向に割りを形成するとともに、前記両側片の何れか一方に、外部配線接続用ターミナルを形成してなることを特徴とする。

[0009]

【作用】本発明に係るECミラーの電極構造によれば、コ字形クリップの対向する両側片のうち、導電膜側に位置した一方は平面形状に形成し、ガラス基板側に位置した他方は、端部が外側が向かって開いた湾曲形状でかつ該側片の中央部分は内側に凸となるように開口が狭まる 10ような突出形状となっているので、基板への嵌め込み時の作業性が高い。また取り出し電極を痛めにくい。さらに嵌め込み時クリップが変形しにくい。さらにまた前記一方の側片の中央部分は内側に凸形状となっているので、嵌合力も高くなり、導電膜と封止樹脂の浸入による取り出し電極部とクリップとの接触不良を避けることができる。

[0010]

【発明の実施の態様】図面を参照して本発明の実施の形 態を、具体的に説明する。図1は、本発明に係るECミ 20 ラー15の電極部の拡大断面図、図2は同じくECミラ 一の縦断面図である。符号1はガラスよりなる透明基板 であり、凸面形状に形成されている。 2 は透明基板の上 面に形成した第1の電極として透明導電層であり、材質 としては、例えばITO、SnO2が用いられる。更に その上に、酸化反応によって着色する例えばIRTOF 等の第1発色層3 a、固体電解質層3 b、還元反応によ って着色する例えば三酸化タングステン等の第2の発色 層3c、第2の電極兼反射層4(材質は、例えばAl、 Agなど)が順次に成膜され、その上を電気絶縁性の封 30 止樹脂5及びガラス製保護基板6で覆われている。なお 第1の発色層と第2の発色層の材料を入れ替えて構成さ れることもある。なお図1、図2は各層の厚み、または 曲率については誇張して描いている。

【0011】第1の電極と第2の電極との間には、外部配線を介して所定の直流電圧を印加し、その極性を切り替えると、第1、第2のEC層内で電気化学的に酸化、還元反応が行なわれて、第1EC層及び第2EC層が着色したり消色したりするように構成されている。このECミラーは、前記の着色、消色の現象により通過光の吸40収率が変化して反射率が変化することにより、防眩ミラーとしての機能を発揮する。

【0012】ところで前記第1の電極と第2の電極には、電圧を印加するために、ガラス基板1上に成膜した導電膜2によりそれぞれ取出し(電極)部を所定パターンに形成し、この両取出し(電極)部を、図1に示す本発明の導電材料製クリップ7で基板1を挟みつけたのち、クリップ7のターミナルに外部配線(図略)をハンダ付けするようになっている。

【0013】図1が、本発明のクリップ7で基板1の取 50 た本発明によれば、ほぼコ字型をしたクリップ電極にお

出し(電極)部を挟みつけた状態を示した部分拡大断面図である。図3は、基板1に取り付ける前の、本発明のクリップ7の一例を示す斜視図である。このクリップは、断面がほぼ「コ」の字形に形成されたバネ性を有する金属からなり、導電膜2側に接触する側片8と、基板1を抑える側片9とを有し、その両側片の間にあって両者を接続する連結部10とからなる。導電膜側に位置した一方の側片8は平面形状に形成されているが、ガラス基板側に位置した他方の側片9の端部9aは、外側が向かって丸く開いた湾曲形状をなし、かつ該側片9の中央部分はコ字形開口が狭まるような凸形状9bに形成されている。

【0014】また、前記両対向側片8、9には、図3に示すように、任意の間隔で割り溝11を多数本形成する。割り溝11は、コ字形クリップを長手方向に曲がりやすくするために形成するもので、割り溝の形態はV形、U形等任意である。12は、クリップの一例として導電膜側の側片8の上部に切起こして突出するように設けたターミナルである。該ターミナル12には、外部配線をハンダ付け、または巻きつけ等の手段により接続することができるようになっている。なお、このターミナルの位置は、任意で、側片の先端に形成してもよい。また基板側の側片9の下部に突出するように設けることもある。

【0015】クリップ?を形成するための好ましい金属としてはりん青銅が挙げられるが、そのほかにステンレス鋼、はがね、ベリウム銅合金等を使用することができる。この金属クリップは、少なくとも取出し(電極)部との接触面に、スズ、その他の導電性物質をメッキしてもよい。

[0016]

【発明の効果】本発明に係るコ字形クリップの対向する 両側辺のうち、導電膜側に位置した一方は平面形状に形 成されて導電膜との密着性を良くし、ガラス基板側に位 置した他方は、端部外側が向かって丸く開いた湾曲形状 であるので、クリップを基板へ嵌め込みむとき挿入しや すく、また、取り出し電極を傷付けにくい。さらに嵌め 込み時クリップが変形しにくいという利点がある。また 該側片の中央部分は内側に凸となるように開口が狭まる ような突出したR形状となっているので、クリップが基 板に噛み付くつく力も高くすることができた。本発明者 の実験によれば、本発明のクリップをガラスに挟み、そ の嵌合力をオートグラフで測定して従来構造品と比較し た。基板に噛み付く力(装着力)は従来構造品が87. 5gf(n=10) であるところ98. 3gf(n=1)0) であり、11%以上嵌合力が高まるという効果を確 認した。また本発明のクリップにつき、高温高湿テスト を行ったところ、封止樹脂の膨張による取り出し電極部 とクリップとの接触不良を生じないことを確認した。ま

ける対向する両端辺に、電極の長手方向と直交する方向に多数の割り溝を形成したものであるから、両端辺が湾曲または波打つ傾向が無くなり、さらに基板端面が曲率を有していても、基板に沿ってクリップ電極を容易に曲げることができるから、取りだし電極部との接触面積が多くなり、基板との密着性が高まるという効果を有している。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明ECミラーの電極部の拡大断面図 である。

【図2】図2は同じくECミラーの縦断面図である。

【図3】図3は本発明のクリップの一例を示す斜視図である。

【図4】図4は湿潤条件下における本発明ECミラーの電極部の説明図である。

【図5】図5(A)(B)は従来のクリップ構造を示した断面図である。

【図6】図6は湿潤条件下における従来のクリップの電

極部の説明図である。

【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 透明導電層 (第1の電極)
- 3 a 第1のEC層 (発色層)
- 3 b 電解質層
- 3 c 第2のEC層 (発色層)
- 4 反射層 (第2の電極)
- 5 封止樹脂層
- 10 6 保護層
 - 7 クリップ
 - 8,9 側片
 - 9 a 端部
 - 9 b 凸出部
 - 10 連結部
 - 11 割り溝
 - 12 ターミナル

